

### Lagenaufbau

| Ebene | Komponente           | Dicke (mm) | Cu (my) | Typ       |
|-------|----------------------|------------|---------|-----------|
| 1     | Cu+galv.Cu<br>Tr-Lam | 0.41       | 18+25   |           |
| 2     | Cu                   |            | 35      |           |
|       | Prepreg              | 0.048      |         | 106       |
|       | No-Flow-PP           | 0.063      |         | 106       |
|       | No-Flow-PP           | 0.063      |         | 106       |
| 3     | Abdeckfolie          | 0.075      |         | PI+Kleber |
| 4     | Cu                   |            | 35      |           |
|       | Flex-Lam             | 0.065      |         | PI+Kleber |
|       | Cu                   |            | 35      |           |
|       | Abdeckfolie          | 0.075      |         | PI+Kleber |
|       | No-Flow-PP           | 0.063      |         | 106       |
|       | No-Flow-PP           | 0.063      |         | 106       |
|       | Prepreg              | 0.048      |         | 106       |
| 5     | Cu                   |            | 35      |           |
| 6     | Tr-Lam<br>Cu+galv.Cu | 0.41       | 18+25   |           |

|  |      |         |
|--|------|---------|
| Presslingsdicke*                             | 1,41 | +/- 10% |
| Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske* | 1,52 | +/- 10% |

### Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- \* Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

## Designrules zum Lagenaufbau

|                                |                                     |          |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Durchgangslöcher [A]<br>(Vias) | End-Ø                               | ≥ 200 µm |
|                                | Viapad-Ø                            | ≥ 500 µm |
| Leiterbild Außenlagen          |                                     |          |
| Standard                       | Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer  | ≥ 100 µm |
|                                | Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer | ≥ 120 µm |
|                                | Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer  | ≥ 130 µm |
|                                | Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer | ≥ 175 µm |
| Leiterbild Innenlagen          |                                     |          |
| Standard                       | Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer  | ≥ 65 µm  |
|                                | Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer | ≥ 80 µm  |
| Standard                       | Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer  | ≥ 85 µm  |
|                                | Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer | ≥ 100 µm |